

マイクロソルダリング技術 教育・認証フェスタ ～電子デバイス実装の展開～

【主催】

一般社団法人 日本溶接協会

マイクロソルダリング要員認証委員会、マイクロソルダリング要員評価委員会、マイクロソルダリング教育委員会

【開催日時および会場】

平成25年10月22日（火）10：30～16：55 於：芝浦工業大学 豊洲キャンパス 交流棟 大講義室

【開催趣旨】

電子・電気製品を支える実装技術は様々な分野で目まぐるしく変化する新技術を採用した製品が作られており、厳しい環境での使用や長期運用など、高い製造技術・材料・評価試験方法・検査方法による高い品質、高い信頼性が求められています。

日本溶接協会では、平成4年よりマイクロソルダリング技術の教育および技術資格の認証を行っており、累計で2万人を越える皆様にご活用頂いております。その資格取得者を中心に様々な方々に対して、最新のマニュアルソルダリング用機器・材料・装置の展示、

最新の技術動向を通じてマイクロソルダリング実装の展開を知って頂く場として、平成18年から「マイクロソルダリング技術 教育・認証フェスタ」を開催しております。

本年度は、「電子デバイス実装の展開」をテーマに、これまでの実装関連の変遷、海外での取り組みや最新の情報をご紹介させて頂くことと致しました。事業主や製造責任者の方々にも参加頂き、基盤技術としてのマイクロソルダリング技術・実装技術を深くご理解頂ければ幸いです。

【プログラム】

10:30-10:35	開会の挨拶	マイクロソルダリング教育委員会 委員長 佐藤 武彦
10:35-11:30	「エレクトロニクス製造業の成り立ち、課題、そして取り組みについて」 京都リサーチパーク(株)フェロー 兼 大阪大学 招聘教授 貢井 孝	
11:30-12:20	展示品紹介（5分程度／1社）	
12:20-13:40	昼食休憩・展示見学	
13:40-14:00	マイクロソルダリング技術賞 表彰式	
14:00-14:40	「海外製造における実装工程管理」 (株)東芝 生産技術センター 加藤 正幸	
14:40-15:20	「電子デバイス実装機の変遷と開発動向」 パナソニック ファクトリーソリューション(株) マーケティング戦略室 佐藤 信一	
15:20-15:40	休憩・展示見学	
15:40-16:20	「ソルダリング用フラックスの変遷と開発動向」 (株)タムラ製作所 開発本部 実装材料開発統括部 熊倉 市朗	
16:20-16:50	「熱・振動複合環境負荷に対する信頼性評価」 大阪大学大学院 工学研究科マテリアル生産科学専攻 松嶋 道也	
16:50-16:55	閉会の挨拶	マイクロソルダリング要員評価委員会 委員長 藤本 公三

※ プログラムの題目・内容は変更になる場合があります。予めご了承願います。

なお、最新詳細情報はホームページ「<http://www.jwes.or.jp/ms/>」を参照願います。

« お手数ですが、関係各所に回覧をお願い申し上げます。»

【 参加申込方法 】

本紙下部の申込書(コピー可)に必要事項を記入し、下記申込先にFAXにて平成25年10月11日までにお送り下さい。受付後、折り返し参加票をFAXにて送付致します。フェスタ当日は、必ず会場受付まで参加票をお持ち下さい。参加票をお持ちでは無い方は、ご入場をお断りする場合もございます。

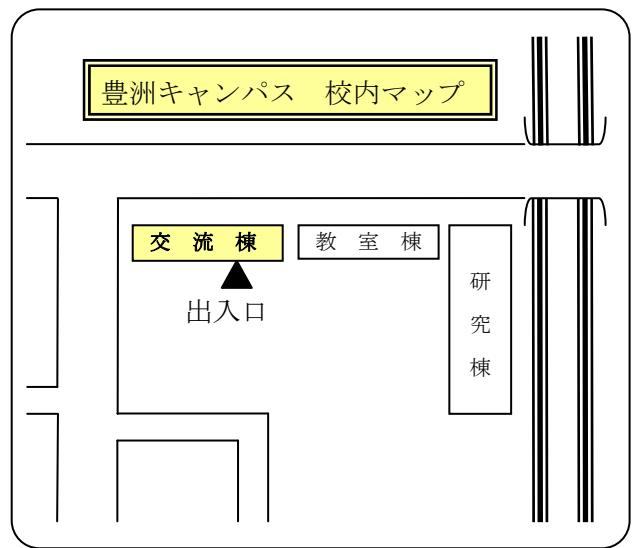
会 場：芝浦工業大学 豊洲キャンパス 交流棟 大講義室（〒135-8548 東京都江東区豊洲3-7-5）

参加定員：400名（先着順、定員になり次第締切り）

参加費用：無 料

お申込先：(一社)日本溶接協会 担当：作道、田川 (TEL: 03-5823-6325 FAX: 03-5823-5211)

【 会場案内図 】



FAX: 03-5823-5211 一般社団法人 日本溶接協会
マイクロソルダリング技術 教育・認証フェスタ 事務局 宛

««参加申込書»»

ふりがな			
氏名	(姓)	(名)	
ふりがな	ふりがな		
勤務先 (所属先名)	電話番号	()	FAX ()
同 上 所在地	〒		
E-mail			

※ 複数のお申し込みの場合には、本紙をコピーしてお使い下さい。